

EVG Introduces Wafer Measurement System Capable of High-Precision Alignment – December 10, 2021

EVG、高精度位置合わせ可能なウエハー測定装置

2021/12/10 化学工業日報 8ページ 528文字

オーストリア・EVG Group (EVG) は9日、ウエハー接合やマスクレス露光向けの新測定装置を開発したと発表した。位置合わせ (アライメント) 精度を数ナノメートルの精度で検証可能。ウエハー全面のアライメント精度向上に向けたオーバーレイモデルを生成でき、系統合差の縮小につながる。最小線幅 (CD) や多層膜厚測定にも対応し、3D実装や複数の異なる機能を持つチップを1デバイスに搭載するヘテロロジーニクス集積などの需要に応えていく。

新たに「EVG40 NT2」(写真)の受注を開始した。量産工程向けで複数の測定ヘッドと高精度な専用ステージを搭載し、リアルタイムのプロセス補正に対応する。ウエハーとウエハー (W2W)、ウエハーとダイ (W2D)、ダイとダイ (D2D) それぞれに対応し、複数顧客とのプロセス開発が進行する。

ウエハー接合ではデバイス間の電気接続確保のため、高精度な位置合わせやオーバーレイが求められる。デバイスの進化にともない接続ピッチの狭域化も課題になっている。マスクレス露光においても反りや歪みによるダイの位置ずれに対応する必要があり、新装置の需要は高いとみる。後工程や微小電気機械システム (MEMS) に向けた高速・高精度な測定機として普及を目指す。

本サービスで提供される記事、写真、図表、見出しその他の情報(以下「情報」)の著作権その他の知的財産権は、その情報提供者に帰属します。

本サービスで提供される情報の無断転載を禁止します。

本サービスは、方法の如何、有償無償を問わず、契約者以外の第三者に利用させることはできません。

Copyrights © 日本経済新聞社 Nikkei Inc. All Rights Reserved.